

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2020-048

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年7月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可〔2020〕1514号），主要内容如下：

- 一、核准公司非公开发行不超过96,465,371股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
- 二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、批复自核准发行之日起12个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

1、发行人：苏州晶方半导体科技股份有限公司

联系部门：证券部

联系人：段佳国、吉冰沁

联系电话：0512-67730001

电子邮箱：info@wlcsp.com

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

联系部门：资本市场部

联系人：何立坤

联系电话：010-88005179

电子邮箱：helikun@guosen.com.cn

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2020年7月24日